

(上接B115版)

记日公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。

- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能触发实施其他风险警示的情形。
- 公司2025年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、公司2025年度利润分配预案

(一)2025年度利润分配方案的具体情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,045,416,530.33元。截至2025年12月31日,母公司累计可供分配利润为663,283,212.41元,资本公积余额为19,927,593,495.86元。

经第七届董事会第十三次会议审议通过,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素,公司拟定2025年度利润分配预案的议案如下:公司以实施股权激励登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2026年3月23日,公司总股本1,261,074,076股,以扣除回购专户已回购的33,921,163股后的股份数为基数,测算拟分配现金红利总额为125,715,291.20元(含税)。

2025年度现金分红(包括2025年中期利润分配方案已分配的金红利482,193,174.40元)总额为607,908,465.60元(含税),占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交至股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形,相关情况如下表所示:

项目	上年度		本年度	
	2025年12月31日(2025年末)	2025年12月31日(2025年末)	2025年12月31日(2025年末)	2025年12月31日(2025年末)
现金分红金额(元)	607,908,465.60	503,090,189.98	107,603,477.30	107,603,477.30
净利润(万元)	909,717,877.16	7	7	7
归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,045,416,530.33	3,323,342,749.08	565,023,300.73	565,023,300.73
归属于上市公司股东的净资产(万元)	602,202,312.41	602,202,312.41	602,202,312.41	602,202,312.41
最近三年平均现金分红占净利润比例(%)	1,299,481,132.88	1,299,481,132.88	1,299,481,132.88	1,299,481,132.88
最近三年平均现金分红占归属于上市公司股东的净资产比例(%)	909,717,877.16	909,717,877.16	909,717,877.16	909,717,877.16
最近三年平均现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例(%)	2,441,427,703.23	2,441,427,703.23	2,441,427,703.23	2,441,427,703.23
最近三年平均现金分红占归属于上市公司股东的净资产比例(%)	2,229,212,564.63	2,229,212,564.63	2,229,212,564.63	2,229,212,564.63
现金分红比例是否低于30%	否	否	否	否
现金分红及(或)上一年度现金分红是否低于《上海证券交易所上市公司规范运作指引》第3.1.1条规定的最低标准	否	否	否	否

注:2025年8月7日,公司已注销存放于公司回购专用证券账户中的11,213,200股股份,并相应减少注册资本,对应支付的总金额为人民币999,731,817.55元。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币4,045,416,530.33元,2025年年度分红派息金额占归属于上市公司股东净利润的比例为15.03%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式及资金需求

公司是主要从事芯片设计业务的Pabless芯片设计公司,公司所处的半导体设计行业为技术密集及资金密集型产业,具有技术迭代迅速、研发投入巨大、产品生命周期较短的特点。基于此,公司高度重视自主研发的技术与产品研发,构建了以客户需求为导向的研发模式,持续加大在各产品领域的研发投入,为产品升级与新建产品的研发提供充分保障。2025年度,公司半导体设计销售业务研发投入金额约为36.80亿元,占公司半导体设计销售业务收入的15.46%,较上年增长13.38%。

目前公司处于扩张成长阶段,公司半导体设计业务聚焦图像传感器解决方案、显示解决方案、模数解决方案三大核心业务板块,2025年度公司实现营业收入2.8855亿元,较2024年增加12.14%,公司实现归属于上市公司股东的净利润为40.45亿元,较2024年增长21.73%。随着公司业务规模持续扩大,公司对资金的需求日益增加,通过持续的技术创新、充足的资本投入及坚实的人才队伍来应对市场与产业的变化与挑战。

(二)上市公司留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润将主要用于加大在图像传感器解决方案、显示解决方案和模数解决方案三大业务领域的研发投入、人力资源建设,扩大市场规模以及补充公司日常运营资金等方面。研发投入是公司作为半导体设计企业长期发展的立身之本,公司将通过加大自主研发、合作研发等方式保持公司的技术优势,增强公司在知识产权和技术方面的优势,拓展公司产品组合,以持续提升市场竞争力;在产品拓展方面,公司计划深化技术市场布局,扩大客户群并提升在各个领域的市场份额。通过上述举措,公司将不断夯实长期竞争壁垒,持续提升盈利能力,从而为股东创造更为坚实的长期投资价值。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司在利润分配方案决策过程中,严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,为中小股东参与决策提供充分便利。公司将股东大会提供网络投票方式,为中小股东参与表决提供便利条件,同时该事项中小投资者单独计票,充分关注中小投资者的决策参与和表决情况。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将聚焦主业,努力提升经营业绩与质量,以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平,并严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定,综合考虑利润分配实际情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求与利润分配的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,兼顾分红政策的连续性和稳定性,努力提升投资者回报水平。

三、提请股东大会授权事项确定2026年度中期利润分配方案
为加大投资者回报力度,分享经营成果,据报投资者的持股信心,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司盈利情况和资金需求状况,拟制定2026年度中期利润分配方案,其中现金分红金额不超过2026年当期归属于上市公司股东净利润,并提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件的情况下制定2026年度中期利润分配方案并办理中期利润分配相关事宜。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第七届董事会第十三次会议,公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案尚需提交至股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

五、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司
2026年3月31日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-021
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于申请2026年度银行综合授信额度 及授权对外签署银行借款合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度银行综合授信额度及授权对外签署借款合同相关事项的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求,提高资金运营能力,根据公司经营战略及总体发展规划,公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度,授信总额不超过等值人民币100亿元的人民币授信及外币授信,用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中期票据、银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求,公司视情况提供包括但不限于信用担保,以公司自有(含控股子公司)的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金等资产提供质押或抵押担保作为增信措施,最大限度的保证公司资金使用效益。

上述授信额度不等于公司实际已取得的授信额度,实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准。公司具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定,融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监根据实际情况在上述额度范围内具体执行并签署借款合同、担保合同等相关文件,授信额度范围内无须逐项提请公司董事会审批。授权期限自股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-020
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于2026年度为控股子公司提供担保 额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	是否为其提供担保余额(不含本次担保金额)	是否在前报告期内履行	本次担保是否有反担保
上海豪威集成电路集团有限公司	180.00亿元	243.02亿元	不适用;本次为2026年度新增	否
香港华微电子(集团)有限公司	4.00亿元	4.00亿元	不适用;本次为2026年度新增	否
北京京诚科电技术有限公司	100.00亿元	100.00亿元	不适用;本次为2026年度新增	否

● 累计担保情况

被担保人的累计担保(万元)	/
截至本公告披露之日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	98,000.00
对合并报表范围内上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.81
特别风险提示	1.担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%; 2.担保对象(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产30%; (6&对资产负债率超过70%的上市公司提供担保)
被担保对象	否

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豪威集团”)经营发展需要,公司2026年度预计为控股子公司北京京诚科电技术有限公司(以下简称“北京京诚志”)、香港华微电子(集团)有限公司(以下简称“香港华电子”)、上海豪威集成电路集团有限公司(以下简称“上海豪威”)的银行及其他金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保,担保额度合计不超过等值人民币33亿元人民币及外币融资,提请公司董事会授权公司董事长、总经理或财务总监在上述额度范围内具体执行。

截至本公告披露之日,公司为前述被担保人担保余额约为人民币24.3亿元,本次担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

2026年3月30日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》,该事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。在公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司为控股子公司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。该事项尚需提交至股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额(万元)	截至报告期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保期限(月)	担保费率(%)	是否关联担保	是否有效担保
一、对控股子公司担保									
截至报告期末担保总额超过70%									
豪威集团	上海豪威	100%	90,505.0	2.43	19,000	47.94	6.74%	股东会审议通过之日起12个月内	否
豪威集团	香港华电子	100%	52,474.7	/	4,000	14.24%	股东会审议通过之日起12个月内	否	
豪威集团	北京京诚志	100%	32,759.0	/	10,000	35.6%	股东会审议通过之日起12个月内	否	

(四)担保额度调整情况

上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,控股子公司担保额度可调剂给其他控股子公司使用(资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	被担保人全称	被担保人类型及上市公控股	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
实际控制人	北京京诚科电技术有限公司	全资子公司	持股比例90.50%	91110100003098927
法人	香港华微电子(集团)有限公司	全资子公司	持股比例100%	37126508
法人	上海豪威集成电路集团有限公司	全资子公司	持股比例100%	91310000MA1110259

被担保人名称	2025年12月31日(2025年末)(经审计)				2024年12月31日(2024年末)(经审计)			
	资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产总额	负债总额	净资产	净利润
北京京诚科电技术有限公司	306,694,533.00	34,079,243.00	272,615,290.00	4,045,416.53	4,000,000.00	19,000,000.00	15,000,000.00	17,320.00
香港华微电子(集团)有限公司	92,778,900.00	92,778,900.00	0.00	0.00	27,104.47	27,104.47	0.00	0.00
上海豪威集成电路集团有限公司	301,397,749.26	23,408,631.00	277,999,118.26	60,000.00	104,749.26	104,749.26	0.00	-1,000.00
合计	600,871,282.26	150,267,174.00	450,604,108.26	41,045,416.53	131,814.73	131,814.73	15,320.00	16,320.00

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:由公司(和/或)控股子公司以连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式为被担保人提供担保。

2.担保金额:为控股子公司银行及其他金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保,担保额度合计不超过等值人民币33亿元人民币及外币融资。

3.上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用(资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度)。

4.在股东大会批准上述担保事项的前提下,董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监审批在上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

6.在公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司(和/或)控股子公司为上述被担保人在以上担保的总额度内,签订的担保合同均为有效。

上述担保担保总额度内,签订的担保合同均为有效。

四、担保的必要性和合理性

(一)本次预计的担保额度是基于公司及控股子公司的经营发展需要确定的,增加预计担保额度有利于满足现阶段业务需求,有助于公司及控股子公司经营业务的正常开展,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,符合公司整体利益。

(二)本次担保计划的被担保方均为公司控股子公司,根据公司目前各自的经营情况和未来发展计划,公司及控股子公司经营状况稳定,各控股子公司有能力偿还各自借款,并解除相应担保,担保风险在可控范围内,不存在影响其偿债能力的重大事项。

五、董事会意见

2026年3月30日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为控股子公司的银行及其他金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保,担保额度合计不超过等值人民币33亿元人民币及外币融资。在公司股东大会审议通过之日起12个月内,公司为控股子公司在以上担保的总额度内签订的担保合同均为有效。公司授权公司董事长、总经理或财务总监签署相关担保合同。该事项尚需提交至股东大会审议。

六、累计对外担保数及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,上市公司及其控股子公司提供的对外担保总额为98.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为37.48%;公司无逾期担保的情况。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-022
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度 薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关文件和制度的规定,结合目前经济环境、公司所处地区、行业规模和实际情况并参照行业薪酬水平,公司对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行了确认,并拟定了2026年度薪酬方案,高级管理人员薪酬方案。公司于2026年3月30日召开第七届董事会第十三次会议,逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》,本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过,公司董事、高级管理人员作为利益相关方,在审议涉及本人薪酬事项时均回避了表决,并将《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》提交公司董事会逐项审议。

现将相关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况,结合公司实际业绩情况,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	任职状态	薪酬总额(万元)
陈震	董事长	离任	292.36
洪震	董事	离任	281.36
洪震	董事	离任	75.71
李俊	董事	离任	66.37
朱建强	独立董事	离任	55.00
李忠	独立董事	离任	55.00
胡晓峰	独立董事	离任	63.37
陈震	独立董事	离任	6.00
洪震	独立董事	离任	6.00
高文安	独立董事	离任	14.67
李俊	独立董事	离任	267.89
陈震	董事	离任	117.67
徐尔	财务总监	离任	184.29

注:以上薪酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金等,未包含获得的股份支付金额。上述人员薪酬为在2025年任期内的薪酬金额。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,并经公司董事会审议,针对公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案制定如下:

(一)适用对象

公司董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

(三)董事薪酬方案

1.内部董事薪酬方案

(1)在公司兼任高级管理人员的非独立董事,按公司高级管理人员的薪酬标准确定薪酬;

(2)在公司兼任其他职务的非独立董事根据其在本公司的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法确定薪酬,不再另行领取董事津贴;

在公司兼任其他职务的非独立董事在公司领取的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入等组成,其中,基本薪酬根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定,基本薪酬按月发放;

绩效薪酬分为季度绩效薪酬及年度绩效薪酬,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况,按照季度绩效考核结果及年度绩效考核结果进行发放,按公司薪酬管理制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准;

中长期激励收入以公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实施结果为准。

2.外部董事(独立董事除外)

非在本公司担任职务的非独立董事不向其发放董事薪酬津贴。

3.独立董事方案

公司独立董事在公司领取固定金额津贴,每位独立董事的年度薪酬标准为人民币20万元(含税),自方案生效后按月发放。

(四)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励收入等组成。其中,基本薪酬根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定,基本薪酬按月发放;

绩效薪酬分为季度绩效薪酬及年度绩效薪酬,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况,按照季度绩效考核结果及年度绩效考核结果进行发放,按公司薪酬管理制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准;

中长期激励收入以公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实施结果为准。

(五)其他规定

1.公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行,一定比例的绩效薪酬将于季度报告及公司经审计的年度报告经董事会审议披露后计算发放。

2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、选聘等原因变化的,按其实际任期计算并予以发放。

4.董事薪酬方案尚需提交至股东大会逐项审议通过后方可生效。

5.上述方案中未尽事宜或与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的,以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:603501 证券简称:豪威集团 公告编号:2026-018
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 关于公司未来三年(2026年—2028年) 股东分红回报规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司未来三年(2026年—2028年)股东分红回报规划的议案》,具体内容如下:

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,为进一步落实股东回报政策,规范公司现金分红,增强现金分红透明度,维护投资者合法权益,股东大会制定了《豪威集成电路(集团)股份有限公司未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划》。回报规划内容如下:

一、制定规划考虑的因素

公司着眼于战略目标与未来可持续发展,在综合分析公司实际情况、经营发展目标、公司现金流量状况以及未来发展需要等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来的盈利规模、所处发展阶段、融资环境等情况,建立对投资者透明、稳定的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、制定规划的基本原则

本规划的制定应当符合相关法律法规及《公司章程》的规定,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展,充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求,在满足公司正常生产经营的前提下,实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

三、公司未来三年(2026—2028年)的具体股东回报规划

(一)利润分配形式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润;公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下,具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)公司利润分配的时间间隔

在满足利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

(三)现金分红的条件

公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,现金流充裕,实施现金分红不影响公司正常经营和长期发展;审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(使用募集资金的除外)。

(四)现金分红比例

公司在经营状况良好并且发放股票股利有利于公司股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配方案。在三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%。在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股票股本规划及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股利分配预案,每次分配股票股利时,每10股最多派发的股票股利不超过1股。

(五)差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到90%;

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;